



2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年8月7日

上場会社名 日本電子材料株式会社 上場取引所 東
コード番号 6855 URL <https://www.jem-net.co.jp/>
代表者(役職名)代表取締役社長 (氏名)坂田 輝久
問合せ先責任者(役職名)執行役員 管理部門統括部長 (氏名)石本 浩久 TEL 06-6482-2007
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	4,992	20.6	1,180	357.6	1,264	271.4	868	283.4
2024年3月期第1四半期	4,137	△3.6	258	△49.2	340	△49.7	226	△54.7

(注) 包括利益 2025年3月期第1四半期 1,098百万円(276.2%) 2024年3月期第1四半期 292百万円(△57.5%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第1四半期	68.76	—
2024年3月期第1四半期	17.96	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第1四半期	34,906	25,516	73.1
2024年3月期	34,769	24,670	71.0

(参考) 自己資本 2025年3月期第1四半期 25,516百万円 2024年3月期 24,670百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
2025年3月期	—	—	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	30.00	—	未定	未定

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	10,000	25.0	2,300	—	2,500	—	1,700	—	134.67
通期	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 — 社(社名) 、除外 — 社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

2025年3月期1Q	12,644,938株	2024年3月期	12,644,938株
2025年3月期1Q	15,900株	2024年3月期	15,857株
2025年3月期1Q	12,629,070株	2024年3月期1Q	12,609,514株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 8
(セグメント情報等の注記)	P. 8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 8
(継続企業の前提に関する注記)	P. 8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	P. 8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しに足踏みがみられたものの、雇用・所得環境の改善と各種政策の効果により、緩やかな回復傾向が続きました。しかしながら、物価上昇、欧米における高い金利水準の継続に伴う影響、中国経済の先行き懸念、中東地域をめぐる情勢等により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、生成AI向け需要が拡大する一方で、スマートフォンや自動車向け需要は弱含んだ状態が続く等、一様ではない状況となりました。

このような事業環境の中、当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては、非メモリー向けプローブカードは、国内先行需要向けの拡販が継続したこと等により堅調に推移いたしました。メモリー向けプローブカードにつきましても、先端半導体向け需要に一服感があったものの、前年同四半期に対しては回復傾向となりました。以上により、全体としても前年同四半期を上回る結果となりました。利益面につきましては、売上高の増加に加え、足元の高付加価値製品を含む海外向け需要の増加による国内工場の稼働率向上等により、前年同四半期を大きく上回る結果となりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は4,992百万円（前年同四半期比20.6%増）、営業利益は1,180百万円（前年同四半期比357.6%増）、経常利益は1,264百万円（前年同四半期比271.4%増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては868百万円（前年同四半期比283.4%増）となりました。

報告セグメント別の業績は次のとおりです。

a. 半導体検査用部品関連事業

半導体検査用部品関連事業の売上面につきましては、非メモリー向けプローブカードは、国内先行需要向けの拡販が継続したこと等により堅調に推移いたしました。メモリー向けプローブカードにつきましても、先端半導体向け需要に一服感があったものの、前年同四半期に対しては回復傾向となりました。以上により、全体としても前年同四半期を上回る結果となりました。利益面につきましては、売上高の増加に加え、足元の高付加価値製品を含む海外向け需要の増加による国内工場の稼働率向上等により、前年同四半期を大きく上回る結果となりました。

以上の結果、売上高4,938百万円（前年同四半期比21.3%増）セグメント利益は1,476百万円（前年同四半期比166.5%増）となりました。

b. 電子管部品関連事業

電子管部品関連事業につきましては、売上高53百万円（前年同四半期比19.0%減）、セグメント利益は2百万円（前年同四半期比37.2%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ136百万円増加し、34,906百万円となりました。

これは主として、現金及び預金が758百万円、売掛金が1,146百万円減少しましたが、電子記録債権が714百万円、仕掛品が209百万円、建設仮勘定が1,016百万円増加したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ709百万円減少し、9,390百万円となりました。

これは主として、設備電子記録債務が189百万円、未払法人税等が158百万円増加しましたが、買掛金が700百万円、長期借入金が302百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ846百万円増加し、25,516百万円となりました。

これは主として、利益剰余金が615百万円、為替換算調整勘定が229百万円増加したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日(2024年8月7日)「2025年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想及び通期連結業績予想の修正、並びに剰余金の配当予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしましたのでご参照ください。

通期の業績及び期末配当の予想につきましては、一旦取り下げさせていただき、予想が可能になった時点で速やかに公表いたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,217	13,458
受取手形	1	—
電子記録債権	1,308	2,023
売掛金	6,530	5,384
有価証券	34	37
製品	384	411
仕掛品	1,249	1,459
原材料及び貯蔵品	2,079	2,094
その他	349	482
貸倒引当金	△13	△10
流動資産合計	26,143	25,340
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,563	2,514
機械装置及び運搬具（純額）	3,055	3,061
建設仮勘定	1,084	2,101
その他（純額）	1,192	1,273
有形固定資産合計	7,896	8,950
無形固定資産	186	202
投資その他の資産		
その他	544	414
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	543	413
固定資産合計	8,626	9,566
資産合計	34,769	34,906
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	1,026	1,044
買掛金	1,152	451
設備電子記録債務	323	513
1年内償還予定の社債	100	100
1年内返済予定の長期借入金	1,178	1,214
未払法人税等	142	300
賞与引当金	471	246
その他	1,124	1,176
流動負債合計	5,519	5,047
固定負債		
社債	900	900
長期借入金	3,480	3,178
その他	199	264
固定負債合計	4,580	4,342
負債合計	10,099	9,390

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,069	3,069
資本剰余金	3,289	3,289
利益剰余金	17,626	18,242
自己株式	△16	△16
株主資本合計	23,969	24,585
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6	7
為替換算調整勘定	693	923
その他の包括利益累計額合計	700	930
純資産合計	24,670	25,516
負債純資産合計	34,769	34,906

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年6月30日)
売上高	4,137	4,992
売上原価	2,755	2,714
売上総利益	1,382	2,277
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	236	267
退職給付費用	4	4
研究開発費	457	386
その他	425	438
販売費及び一般管理費合計	1,124	1,096
営業利益	258	1,180
営業外収益		
受取利息	5	7
受取配当金	22	2
為替差益	57	80
その他	2	2
営業外収益合計	88	93
営業外費用		
支払利息	5	7
社債利息	—	1
その他	0	0
営業外費用合計	5	9
経常利益	340	1,264
税金等調整前四半期純利益	340	1,264
法人税、住民税及び事業税	76	252
法人税等調整額	37	143
法人税等合計	113	395
四半期純利益	226	868
親会社株主に帰属する四半期純利益	226	868

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期純利益	226	868
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	0	0
為替換算調整勘定	64	229
その他の包括利益合計	65	230
四半期包括利益	292	1,098
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	292	1,098

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	4,071	66	4,137	—	4,137
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	4,071	66	4,137	—	4,137
セグメント利益	553	4	558	△ 300	258

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	4,938	53	4,992	—	4,992
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	4,938	53	4,992	—	4,992
セグメント利益	1,476	2	1,479	△ 298	1,180

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
減価償却費	260百万円	277百万円